

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 7 部門第 2 区分
【発行日】平成24年5月10日 (2012.5.10)

【公開番号】特開2011-14837(P2011-14837A)
【公開日】平成23年1月20日 (2011.1.20)
【年通号数】公開・登録公報2011-003
【出願番号】特願2009-159953(P2009-159953)
【国際特許分類】

H 0 5 K 7/20 (2006.01)

【 F I 】

H 0 5 K 7/20 B

【手続補正書】

【提出日】平成24年3月19日 (2012.3.19)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

主表面及び前記主表面と反対側の裏面とを有する発熱部品と、
前記主表面上に配置され、前記発熱部品を駆動するための実装部品が搭載された回路基板と、
前記裏面上に配置され、前記発熱部品が発生する熱を放熱するためのヒートシンクとを備えた電子機器において、

前記主表面上から前記ヒートシンクまで延在する熱伝導体を有し、前記回路基板と前記発熱部品との間に配置された補助ベースを備えたことを特徴とする電子機器。

【請求項 2】

前記ヒートシンクには前記熱伝導体を通過せしめる貫通孔が前記発熱部品の一方の側に設けられ、前記熱伝導体は前記ヒートシンク側に突出することを特徴とする請求項 1 記載の電子機器。

【請求項 3】

前記熱伝導体は第 1 熱伝導体群及び第 2 熱伝導体群より成り、前記第 1 熱伝導体群は前記貫通孔を通過し、
前記ヒートシンクの前記一方の側とは反対側の他方の側には前記第 2 熱伝導体群を通過せしめる第 2 の貫通孔が設けられたことを特徴とする請求項 2 記載の電子機器。

【請求項 4】

前記補助ベースは前記回路基板を固定する固定手段を備えたことを特徴とする請求項 1 乃至 3 のいずれか 1 項に記載の電子機器。

【請求項 5】

前記熱伝導体は、前記発熱部品が発生する熱及び前記実装部品が発生する熱を前記ヒートシンクに伝えることを特徴とする請求項 1 乃至 4 のいずれか 1 項に記載の電子機器。

【請求項 6】

前記ヒートシンクには、第1の方向に冷媒が流れていることを特徴とする請求項 1 乃至 5 のいずれか 1 項に記載の電子機器。

【請求項 7】

前記熱伝導体は前記第 1 の方向と平行な方向に扁平する扁平部を備えたことを特徴とする請求項 6 記載の電子機器。

